【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和4年6月9日(2022.6.9)

【国際公開番号】WO2020/209269
【出願番号】特願2021-513654(P2021-513654)
【国際特許分類】
H01L 21/60(2006.01)
H05K 13/04(2006.01)
【FI】
H01L 21/60 311T
H05K 13/04 B

【手続補正書】
【提出日】令和3年2月8日(2021.2.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
キャリアテープから電子部品を取り出し、取り出した前記電子部品を搬送する電子部品提供モジュールと、
半導体ダイを突き上げてダイシングシートに貼り付けられたウェハから前記半導体ダイをピックアップするピックアップ部を有し、ピックアップした前記半導体ダイを搬送するダイ提供モジュールと、
前記ダイ提供モジュールから提供される前記半導体ダイ及び前記電子部品提供モジュールから提供される前記電子部品の少なくとも一方を基板に配置するボンディングモジュールと、を備え、
前記電子部品提供モジュールは、前記キャリアテープから取り出された前記電子部品を前記電子部品提供モジュールから搬出する第１搬送部を有し、
前記ダイ提供モジュールは、ピックアップされた前記半導体ダイを前記ダイ提供モジュールから搬出する第２搬送部を有し、
前記第１搬送部及び前記第２搬送部のいずれか一方は、前記電子部品及び前記半導体ダイの両方を前記ボンディングモジュールに搬送する共通搬送路であり、他方は、前記電子部品及び前記半導体ダイのいずれか一方を前記共通搬送路に搬出する独立搬送路である、ボンディング装置。
【請求項２】
（削除）
【請求項３】
前記第１搬送部及び前記第２搬送部は、所定の搬送方向に向けて前記半導体ダイ及び前記電子部品を搬送する、請求項１に記載のボンディング装置。
【請求項４】
前記搬送方向に沿って、前記電子部品提供モジュール、前記ダイ提供モジュール及び前記ボンディングモジュールの順に配置されている、請求項３に記載のボンディング装置。
【請求項５】
前記ボンディングモジュールは、前記第１搬送部から前記電子部品を受け取り可能であって受け取った前記電子部品を前記基板に配置すると共に、前記第２搬送部から前記半導体ダイを受け取り可能であって受け取った前記半導体ダイを前記基板に配置する配置手段

を有する、請求項１、３、４のいずれか一項に記載のボンディング装置。